

Für unseren Standort Rot am See suchen wir  
**einen Praktikant (m/w)**  
 für den Bereich Forschung & Entwicklung

**Schwerpunkt** Aufbau- und Verbindungstechnik

**Thema** Aufbau Laborumgebung für Drahtbonden und Die-Bonden

Die beste Technologie bleibt verborgen und kann nicht genutzt werden, wenn es keinen Zugang zu dieser gibt. Basierend auf den Ergebnissen dieser Arbeit im Bereich Aufbau- und Verbindungstechnik stehen neuartige Aufbauten und Systeme im Mittelpunkt der Entwicklung für Leiterplattentechnologien. Grundsätzlich sollte hier eine Arbeitsumgebung geschaffen werden, die eine Nutzung der aufgebauten Prozesse im Forschungs- und Entwicklungsumfeld ermöglichen.

Die Aufgaben gliedern sich in folgende Schwerpunkte:

- Inbetriebnahme semiautomatischer Drahtbonder
- Parameterdefinition Gold- und Aluminiumdrahtbonden für Chip-on-board (COB)
- Inbetriebnahme manueller Die-Bonder
- Parameterdefinition für Die-Bond Anwendungen auf Leiterplattenmaterialien und Kupferfolien
- Erstellen Dokumentation der Anlagen/Prozesse
- Entwurf einer Schnittstelle für externe/interne Nutzer
- Kombination der erarbeiteten Technologien mit neuartigen Leiterplattentechnologien (z.B. Einbetten von Komponenten in Leiterplatten)

**Qualifikation** Student/in der Bereiche Elektrotechnik, Mikrosystemtechnik oder ähnlicher Studiengänge

**Zeitraum / Dauer** ab sofort, ca. 6 Monate

**Ihre Bewerbung** richten Sie bitte an:  
 Würth Elektronik Rot am See GmbH & Co. KG  
 Forschung und Entwicklung  
 Christiane Burkhardt  
 Rudolf-Diesel-Straße 10  
 74585 Rot am See  
 Tel. +49 (0) 79 55 38 88 07 - 150  
 christiane.burkhardt@we-online.de  
 www.we-online.de